

厚薄膜混合集成电路及应用



作者：张如明，张经国，韩学鸿

出版社：北京：国防工业出版社

出版日期：1986. 09

总页数：240

说明：登录教客网 (<https://www.jiaokey.com/book/detail/10816784.html>) 查找全本阅读方式

厚薄膜混合集成电路及应用 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10816784.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10816784.html>

书名：厚薄膜混合集成电路及应用